

No.	項目	內容描述	工藝能力
1	可生產層數	層	基板, 1層 (單面), 2層 (雙面), (實驗室可完成四層)
2	材料	-	氧化鋁,氮化鋁,氧化鋯,氧化鉛,氧化矽, 藍寶石,金剛石,氮化矽
3	表面處理工藝	-	沉金, OSP, 沉銀, 鍍金, 沉鍍鈀金
4	阻焊顏色	-	綠色, 黑色, 啞光黑色, 藍色, 紅色, 白色,啞光綠色
5	字元顏色	-	白色, 黑色
6	可製造板厚範圍	mm	0.1-4mm
7	最大板尺寸	mm	標準: 101x101mm,定制作: 205x205mm
8	最小板尺寸	mm	1x1mm
9	外型公差	mm	±0.1mm(標準),±0.03mm(極限)
10	成型方式	-	鐳射,水刀
11	V-CUT	-	鐳射預切
12	最小焊盤	mm	0.15mm
13	最小線寬	mm	0.03mm

14	最小線距	mm	0.03mm
15	層間對對位偏差	mm	0.03mm
16	最小鑽孔	mm	0.06mm
17	出貨方式	-	單片, 連片
18	支援塞孔方式	-	電鍍填孔, 阻焊塞孔
19	板厚公差	mm	標準: 板厚±10%, 極限: ±0.05mm
20	基材厚度公差	mm	±0.03mm
21	可開孔, 槽的形狀	-	圓型, 方型, 異形, 半孔
22	板邊金屬化 (板邊包金)	-	可以
23	導熱係數範圍	W/MK	20-280W/MK
24	銅厚範圍	um	5-175um
25	圍壩高度範圍	-	100-1000um
26	孔徑公差	-	±0.05mm
27	覆銅工藝	-	DPC + 電鍍